

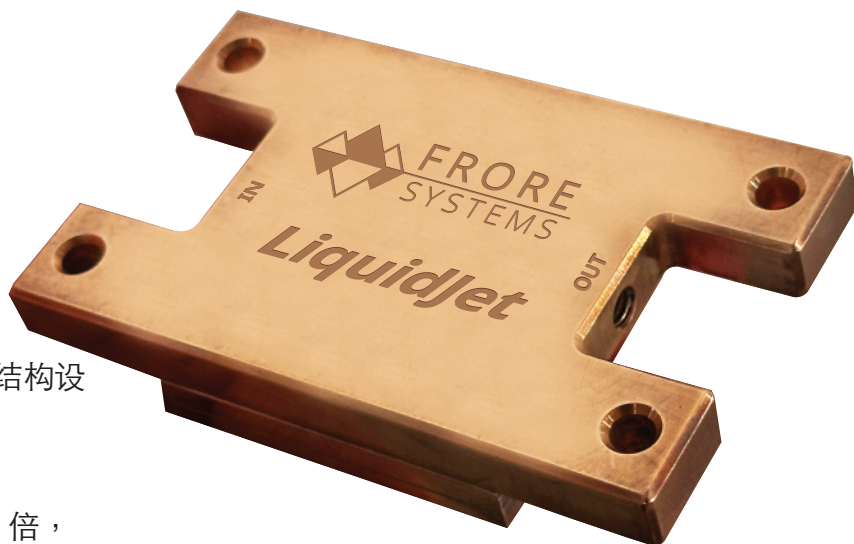
LiquidJet™ 液冷板



热点密度功率提升 2 倍

散热量提升 50%

压降降低 4 倍



凭借业界首创的创新型 3D 短回路喷射通道微结构设计可实现以下性能：

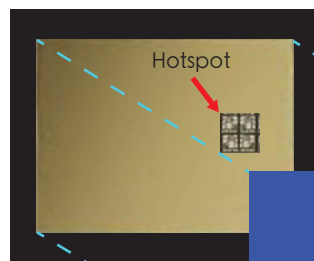
- 在40℃ 进水温度下，热点功率密度提升 2 倍，达 600 W/cm²
- 功率密度 (KW/lpm) 提升 50%
- 压降降低 4 倍
- 定制化设计，精准匹配任意系统级芯片 (SoC) 功率分布
- 便于直接升级替换

Blackwell Ultra上的性能表现

	最佳切削冷板	LiquidJet 液冷板
SoC 功率 (瓦)	1400	1400
微结构压降(psi)	0.94	0.24
PG25 流量 (lpm)	2.1	1.4

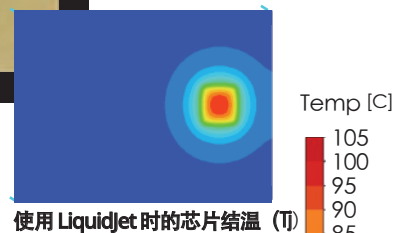
注：最大通道宽度 0.15 毫米 | 进水温度 40℃ | 导热界面材料 (TIM) : PTM7950

具备热点的GPU



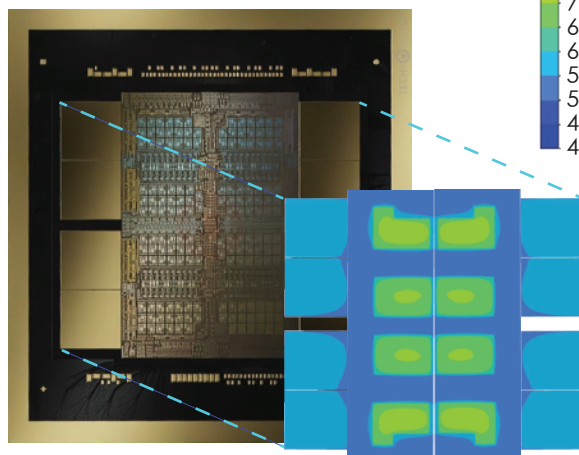
600 W/cm²

使用导热界面材料时热阻为 0.02 K·cm²/W，芯片其余部分为80 W/cm²



使用 LiquidJet 时的芯片结温 (Tj)

Blackwell Ultra



使用 LiquidJet 时的芯片结温 (Tj)

LiquidJet™ 液冷板

定制化冷却

传统冷板通常采用过时的切削式二维微通道工艺，因此难以适应新芯片布局以及越来越不均匀的高功率密度要求。

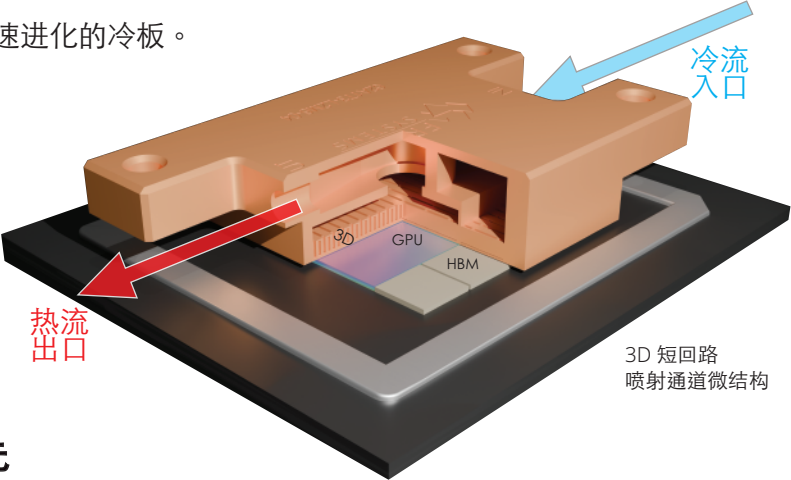
Fröre Systems 则采取不同策略，将半导体制造工艺应用至金属晶圆，并精确制造出符合现代 GPU 功率分布的三维短回路喷射通道微结构。

可根据您的系统级芯片（SoC）功率密度进行定制

最终诞生的 LiquidJet，是一款能与所冷却芯片同速进化的冷板。

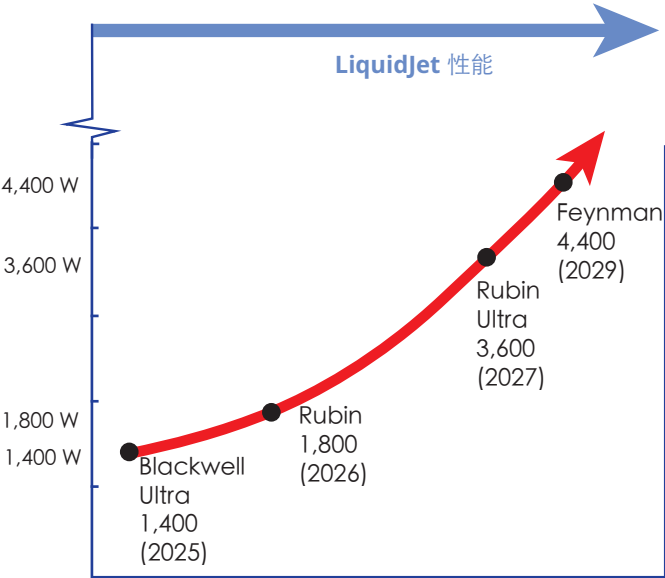
凭借这一突破性技术，数据中心可实现：

- 更低的 GPU 温度
- 更高的 AI 推理速度（每秒生成更多 AI token）
- 更低的总体拥有成本（TCO）
- 更高的电力使用效率（PUE）



LiquidJet——开启 AI 数据中心液冷新纪元

面向未来，兼容 NVIDIA Feynman SoC 及后续更高性能芯片



扫描获取更多信息